



Kompozytowe płyty izolacyjne **termPIR® WS GK** składają się z płyty termPIR WS z rdzeniem z pianki PIR oraz płyty **gipsowo-kartonowej**. Płyty pokryte są z jednej strony gazoprzepuszczalną okładziną z welonu szklanego. Druga strona płyty pokryta płytą gipsowo-kartonową. Pomiędzy płytą termPIR WS, a płytą g-k znajduje się warstwa adhezyjna.

parametry płyty kompozytywnej termPIR WS GK

właściwości		wartości / klasy					
Długość / szerokość		2,6 m (±10 mm) / 1,2 m (±7,5 mm)					
Grubość całkowita (d _N + 12,5 mm)		grubość d _N * płyty termPIR WS oraz grubość płyty karton-gips 12,5 mm					
Wspł. przewodzenia ciepła, λ _D	dla d _N * = 25 mm:	0,026 [W/m·K]					
Opór cieplny, R _D		0,95 [W/m ² ·K]					
Wspł. przewodzenia ciepła, λ _D [W/m·K]	dla d _N * = 20 - 250 mm:	(20 ≤ d _N < 80 mm):		(80 ≤ d _N ≤ 120 mm):		(120 < d _N ≤ 250 mm):	
Opór cieplny, R _D [m ² ·K/W] dla pozostałych grubości		0,026 [W/m·K]		0,025 [W/m·K]		0,024 [W/m·K]	
		20 mm: 0,75	30 mm: 1,15	40 mm: 1,55	50 mm: 1,90	60 mm: 2,30	70 mm: 2,70
		80 mm: 3,20	90 mm: 3,60	100 mm: 4,00	110 mm: 4,40	120 mm: 5,05	130 mm: 5,45
		140 mm: 5,85	150 mm: 6,30	160 mm: 6,70	170 mm: 7,15	180 mm: 7,55	190 mm: 8,00
		200 mm: 8,40	210 mm: 8,80	220 mm: 9,25	230 mm: 9,65	240 mm: 10,1	250 mm: 10,5
* Dotyczy grubości płyty termPIR WS (bez doliczania grubości płyty gipsowo-kartonowej i warstwy kleju pomiędzy płytami).							
Reakcja na ogień (wyrób z zastosowaniu końcowym) Rozprzestrzenianie ognia		Klasa B-s1,d0 "nierozprzestrzeniający ognia" Dotyczy płyt termPIR® WS GK o grubość: 20-140/12,5 mm. Podłoże: Każdy rodzaj podłoża niepalnego i drewnopodobnego. Mocowanie za pomocą klejenia z możliwym mocowaniem mechanicznym. Szczegóły w klasyfikacji.					

parametry płyty termPIR WS

Reakcja na ogień	Klasa E	
Gęstość rdzenia PIR	30 kg/m ³	
Napężenie ściskające przy 10% odkształceniu, σ ₁₀	dla (20 ≤ d _N < 30 mm): ≥ 120 kPa, CS(10/Y)120	dla (30 ≤ d _N ≤ 250 mm): ≥ 150 kPa, CS(10/Y)150

parametry płyty karton-gips (na podstawie deklaracji producenta)

Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0
Przewodność cieplna (dla grubości 12,5 mm)	0,25 [W/m·K]

Dostępne frezy: FIT(frez płaski),LAP(frez schodkowy), TAG(pióro-wpust)

Instrukcja montażu: Płyty montować za pomocą klejenia z dodatkowym mocowaniem mechanicznym (za pomocą wrętów typowych jak do płyty g-k, o długości dobranej do grubości płyty i typu podłoża). Klej dobrać do rodzaju podłoża i okładziny z welonu szklanego - zalecany klej poliuretanowy lub klej do styropianu. Zapoznać się ze specyfikacją kleju. Zalecana temp. montażu: 5 - 20 oC. Zapewnić stabilność podłoża. Przed montażem podłoże oczyścić i (opcjonalnie) zagruntować. Szczeliny dylatacyjne pomiędzy płytami g-k po montażu płyty zafugowuje się i zabezpiecza tak jak typową płytę g-k. Zostawić przerwę pomiędzy podłogą a płytą i zabezpieczyć przez podciąganiem wilgoci. Płyty przechowywać w warunkach suchych. Płyty nie są elementem nośnym.